

MINIOVEN 05

Kompakter Hybrid Reflow-Ofen

Der MINIOVEN ist ein kompaktes und robustes Tischgerät, das speziell für das Reballen von BGA Bausteinen und das Prebumpen von QFN Chips entwickelt worden ist. Einsatz findet das Gerät sowohl im Entwicklungsbereich als auch in der Produktion. Die effiziente Hybridheiztechnologie erwärmt elektronische Bausteine von allen Seiten gleichmäßig und garantiert somit reproduzierbare Reballing Ergebnisse.

Mit der intuitiven Menüführung können bis zu 25 Heizprofilen angelegt, verwaltet und gespeichert werden. Für möglichst hohe Zuverlässigkeit beim automatischen Lernen der Reballing Profile



wird erstmals ein zusätzlicher, externer Temperatursensor benutzt. Mit seiner Hilfe werden die optimalen Profilparameter zum Erreichen der vorgegebenen Bauteiltemperatur ermittelt. Die PC-Software EASYBEAM erlaubt es, Reballing Profile komfortabel zu editieren und die Temperaturentwicklung darzustellen. Neben dem Reballen von BGA Bausteinen sind Bauteilaufnahmen und Vorrichtungen für das Vorbeloten von QFN Bausteinen verfügbar. Das Gerät besitzt einen Anschluss für Prozessgas. Somit können Reflow-Prozesse einfach auf Atmosphäre unter Stickstoff umgestellt werden.

Top Features

Hybridheiztechnologie für beste Temperaturverteilung



Zuverlässigkeit

Optimierte Wärmeverteilung durch Konvektion



Flexibilität

Umschmelzen von Lotpaste oder Lotkugeln



Plug and Play

Kompaktes Format, innovatives Design und intuitive Bedienung



Präzision

Stickstoffanschluss für ein optimales Umschmelzen der Lotkugeln



Prozesskontrolle

Verwendung von Temperaturprofilen über PC Software

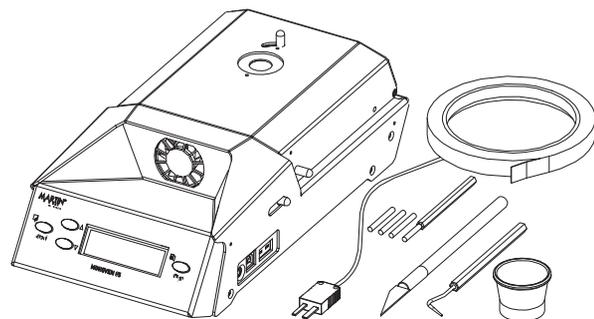


Support

Masken Design nach Kundenwunsch

Ausstattung

- MINIOVEN 05 Basisgerät
- Temperatursensor Typ-K
- Messer
- SMD Haken
- Reinigungsstift mit drei extra Einsätzen
- Rolle Kapton Klebeband
- Lupe
- Netzkabel
- Betriebsanleitung

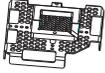


Technische Details

Gesamtleistungsaufnahme:	550 VA	
Leistung Unterheizung:	500 W	4 x IR-Lampen
Größe Unterheizung:	105 x 130 mm ²	
Empf. max. Bauteilgröße:	55 x 55 x 4 mm ³	

Elektrischer Anschluss:	1Phase, 85 - 250 VAC, 50 - 60 Hz
Anzahl Sensoren:	1x intern fest verbaut + 1x extern frei
Profilspeicherplätze:	25 Speicherplätze
Systemabmessungen:	150 x 300 x 40 mm ³

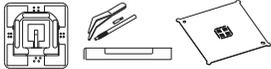
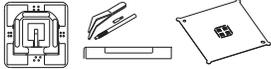
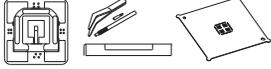
MINIOVEN 05: Ergänzungsbausteine

	Artikel nr.	Name
	HB00.0112	Switch-Box Prozess-Gas für MINIOVEN 05 mit Anschluss-Set
	HB00.4005	Prozessgas Anschluss-Set für MINIOVEN 05
	LW40.0251	Reballing-Halter CSP 27*27mm für MO-04/05 Standard
	LW40.0236	Reballing-Halter BGA 45*45mm für MO-04/05 mit 4 Niederhaltern
	LW40.0237	Reballing-Halter BGA 45*45mm für MO-04/05 mit 4 Niederhaltern+Gitter (geeignet für PS3)
	LW40.0252	Prebumping-Halter mit Printer QFN 27*27mm für MO 04/05

Verbrauchsmaterial

	VD90.5104	Lotkugeln, 50.000 Stk, bleifrei CSP Sn96,5Ag3Cu0,5 250µm (=3g)
	VD90.5101	Lotkugeln, 50.000 Stk., bleifrei BGA Sn96,5Ag3Cu0,5 762µm (=86g)
	HT00.0009	Flux Pen bleifrei 0405 C, no clean, RELO

Anwendungssets

	LW50.9001	Reballing-04 Set eco Standard
	SF29.0002	Prebumping-05 Set QFN
	LW50.9003	Reballing Set PS 4

Weiteres Zubehör und Verbrauchsmaterial unter www.martin-smt.de